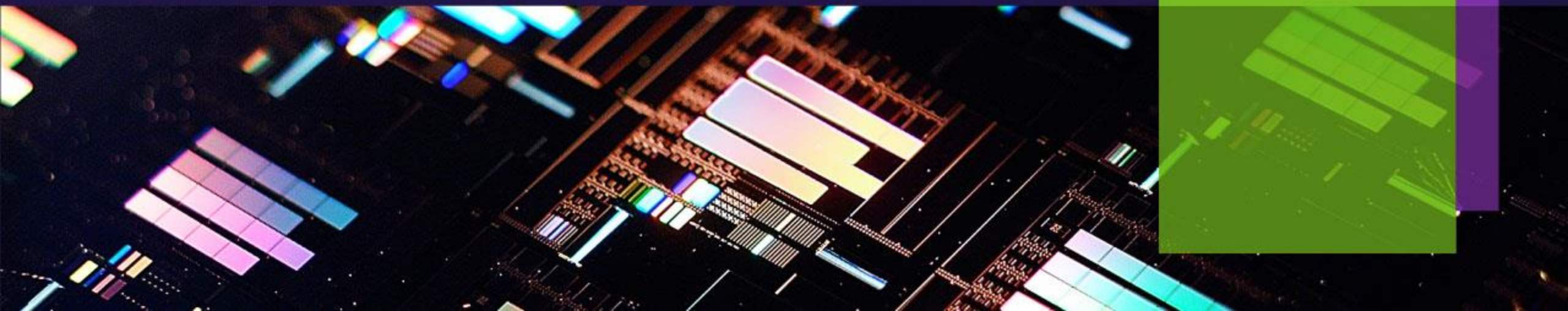


2023年3月期（2022年4月～2023年3月） 東京エレクトロン 決算説明会

2023年5月11日

内容：

- 連結決算の概要 執行役員 ファイナンスユニットGM 川本 弘
- 事業環境および業績予想 代表取締役社長・CEO 河合 利樹



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、地政学的リスク、半導体/FPD*市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスク、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

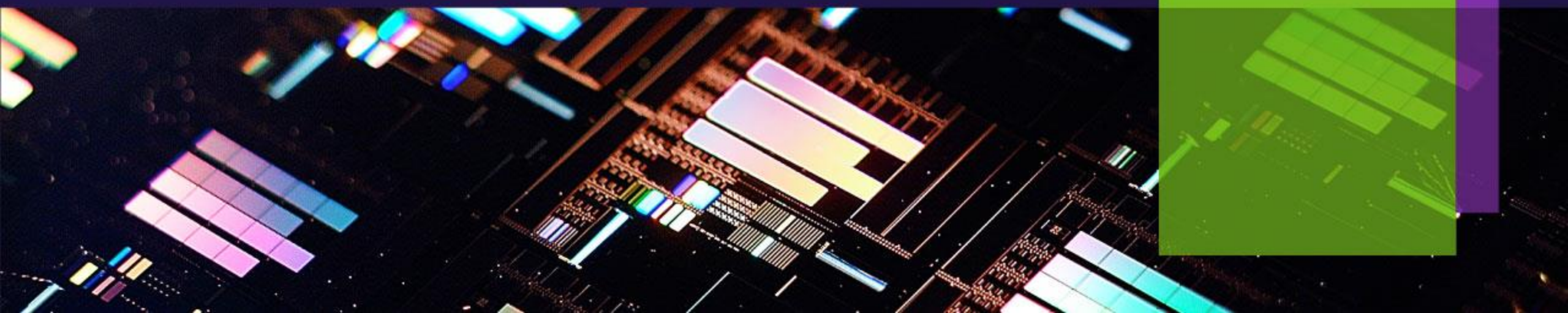
当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は極めて軽微です。

* FPD : フラットパネルディスプレイ

2023年3月期連結決算の概要

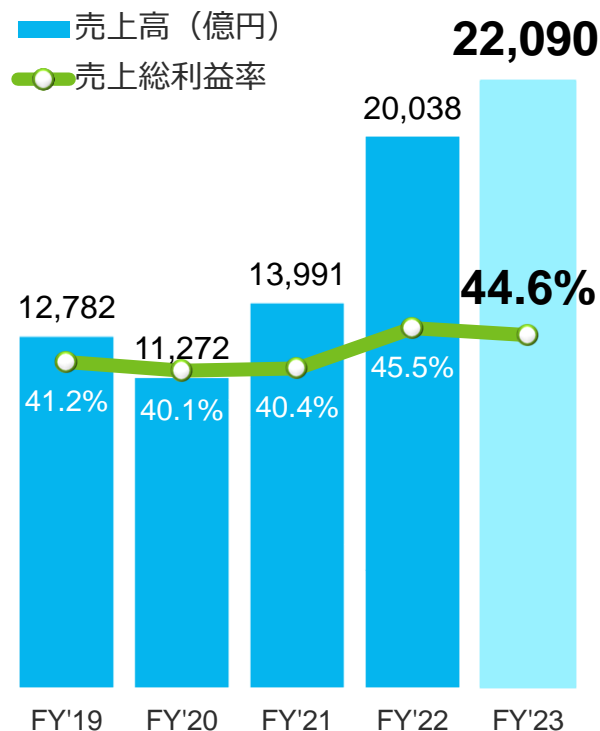
2023年5月11日

川本 弘
執行役員 ファイナンスユニットGM

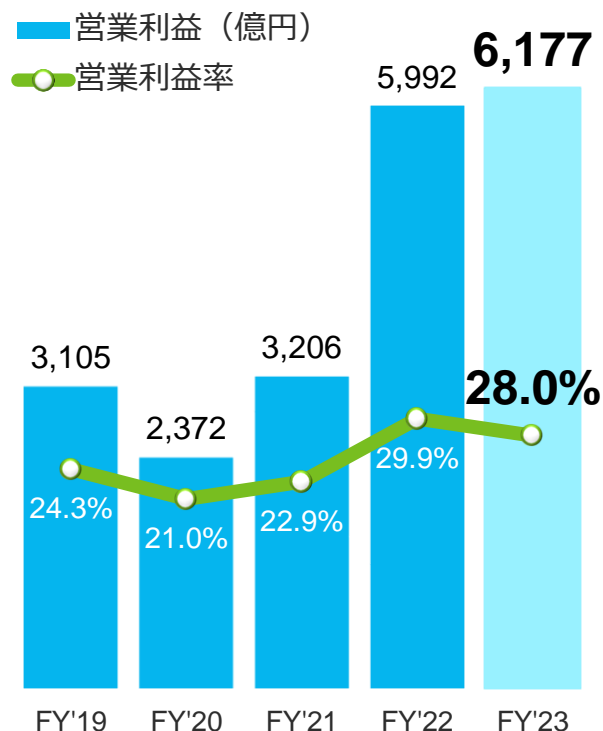


FY2023（2022年4月～2023年3月）財務ハイライト

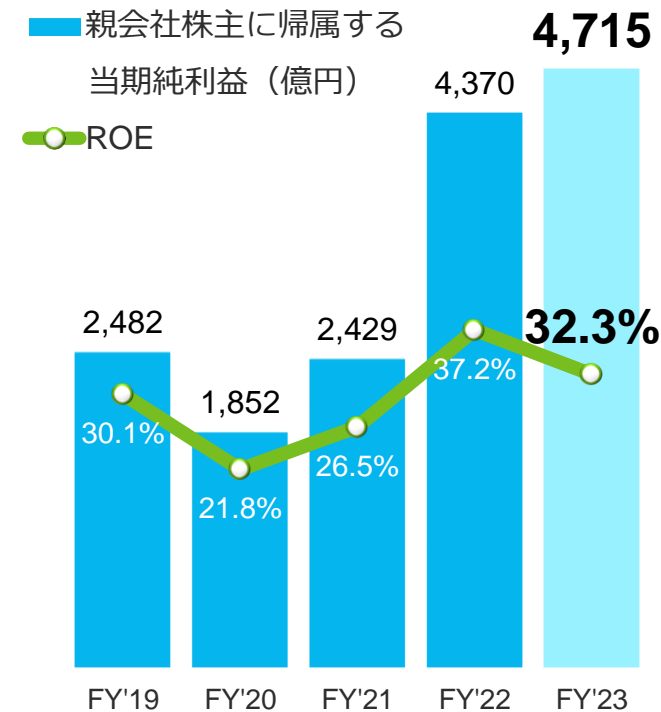
売上高と売上総利益率



営業利益と営業利益率



親会社株主に帰属する 当期純利益とROE



FY2022の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しています。

- SPE*需要の拡大に確実に対応。前期比+10%の増収
- 営業利益・当期純利益ともに過去最高を更新

* SPE：半導体製造装置

損益状況

(億円)

	FY2022	FY2023	対前期 増減	(ご参考) 2023年2月9日発表の FY2023予想
売上高	20,038	22,090	+10.2%	21,700
SPE	19,438	21,552	+10.9%	21,180
FPD	598	536	-10.3%	520
売上総利益	9,118	9,844	+8.0%	9,460
下段：売上総利益率	45.5%	44.6%	-0.9pts	43.6%
販管費	3,125	3,666	+17.3%	3,660
営業利益	5,992	6,177	+3.1%	5,800
下段：営業利益率	29.9%	28.0%	-1.9pts	26.7%
税金等調整前当期純利益	5,966	6,248	+4.7%	5,840
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,370	4,715	+7.9%	4,330
1株当たり当期純利益 (円)	935.95	1,007.82	+7.7%	925.38
研究開発費	1,582	1,911	+20.8%	
設備投資額	572	744	+29.9%	
減価償却費	367	429	+16.9%	

1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上計上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。
3. 1株当たり当期純利益は株式分割後の自己株式を除く発行済株式総数をもとに計算しています。

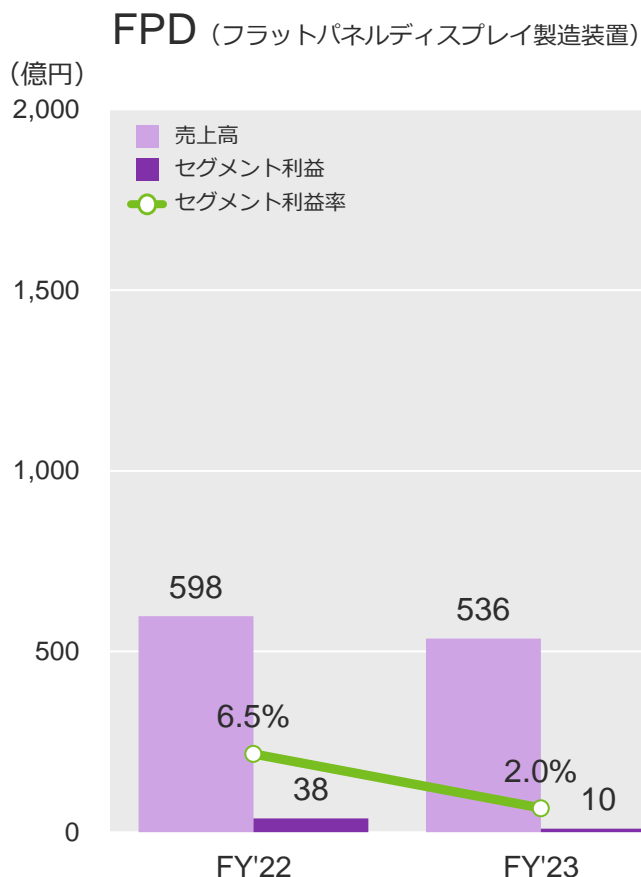
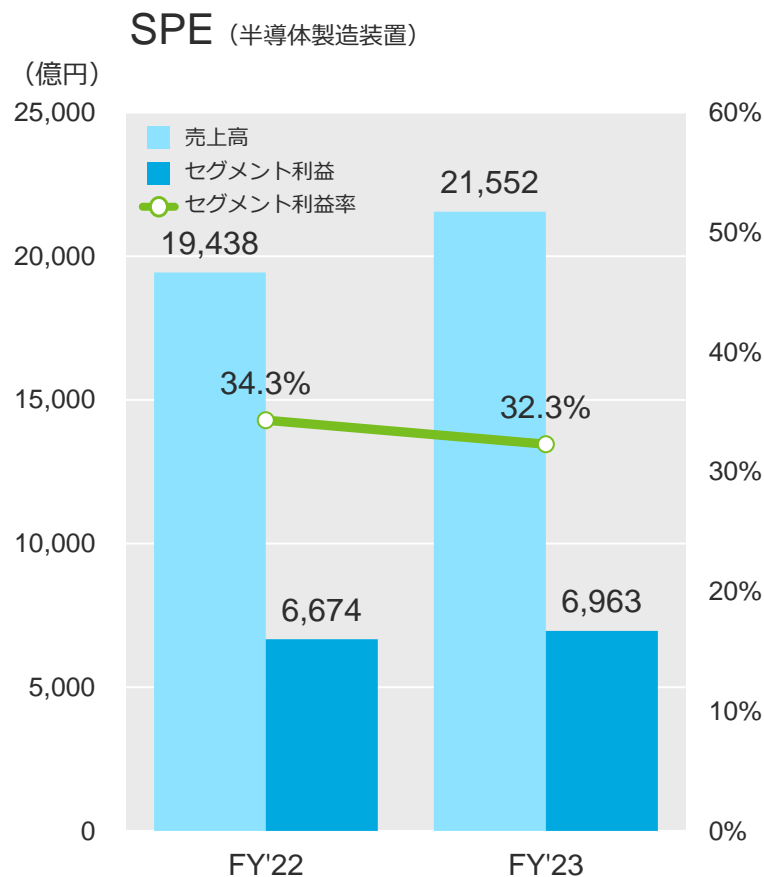
損益状況（四半期）

（億円）

	FY2022	FY2023				対FY2023 Q3 増減
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
売上高	5,648	4,736	7,092	4,678	5,582	+19.3%
SPE	5,492	4,640	6,890	4,588	5,433	+18.4%
FPD	155	96	201	89	149	+66.5%
売上総利益	2,559	2,005	3,282	2,039	2,516	+23.4%
下段：売上総利益率	45.3%	42.3%	46.3%	43.6%	45.1%	+1.5pts
販管費	873	830	956	891	989	+11.0%
営業利益	1,685	1,175	2,326	1,147	1,527	+33.1%
下段：営業利益率	29.8%	24.8%	32.8%	24.5%	27.4%	+2.9pts
税金等調整前当期純利益	1,681	1,176	2,352	1,163	1,556	+33.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,268	880	1,792	855	1,186	+38.7%
研究開発費	441	421	491	461	537	+16.6%
設備投資額	147	180	173	125	263	+109.8%
減価償却費	102	97	98	112	120	+7.0%

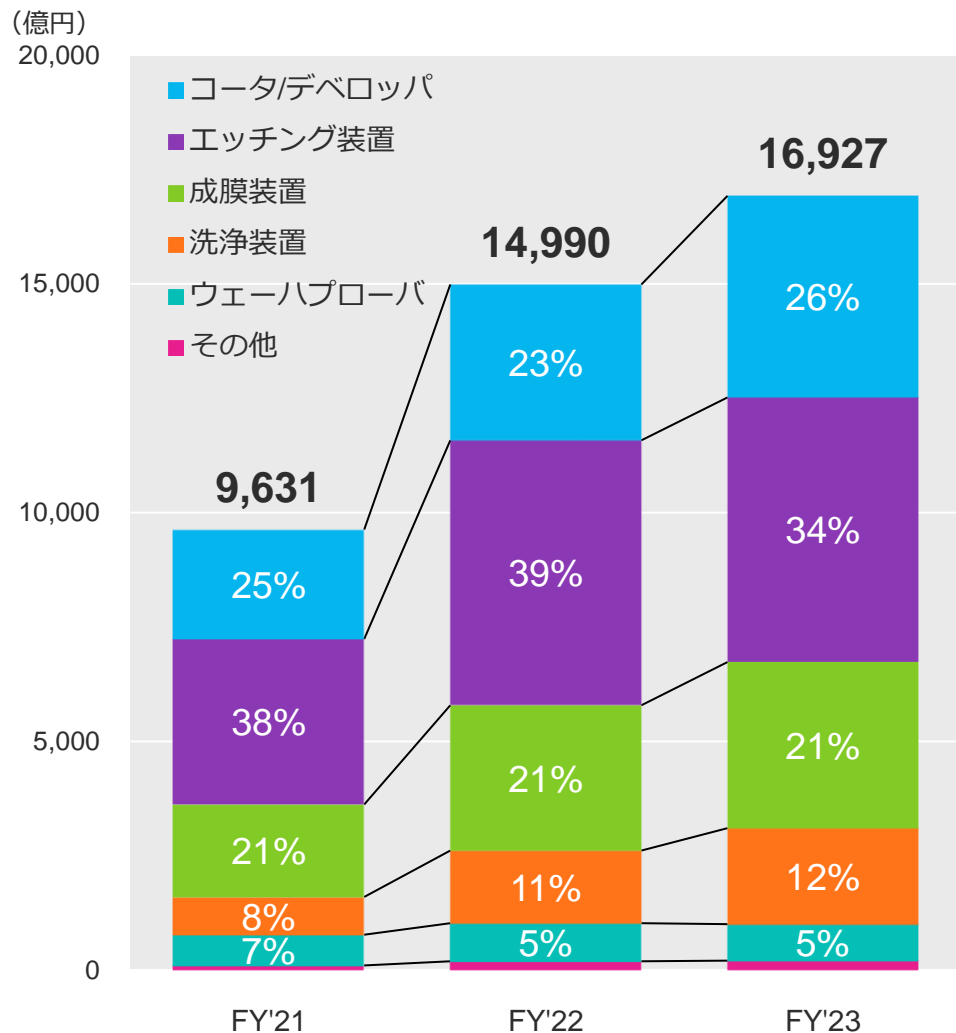
1. 当社の主力製品である半導体製造装置およびFPD製造装置の輸出売上計上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

セグメント情報



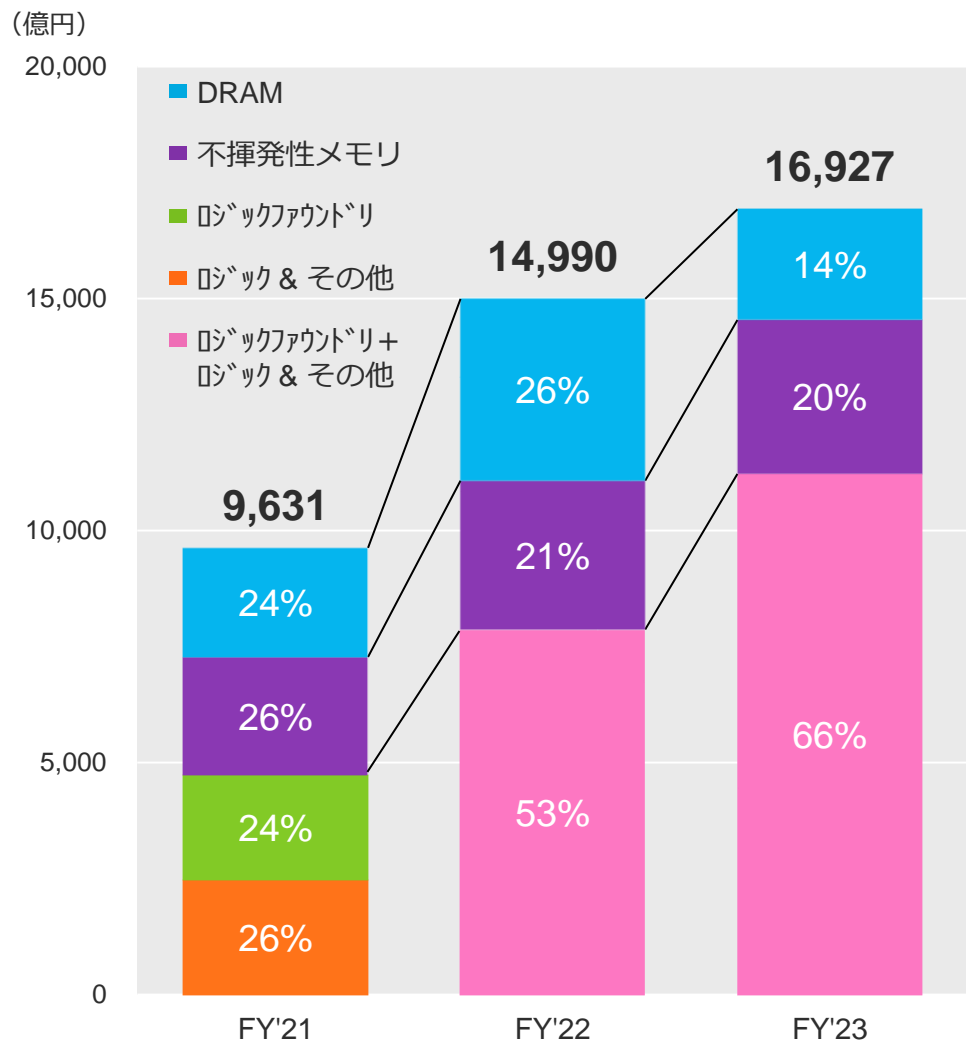
1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

SPE部門 新規装置 製品別売上構成比



- FY2023 新規装置の売上は、前期比+12.9%の 16,927億円
- 顧客の投資ミックスの変化に伴い、装置構成比に変動はあったものの全体として新規装置売上は前期比増加

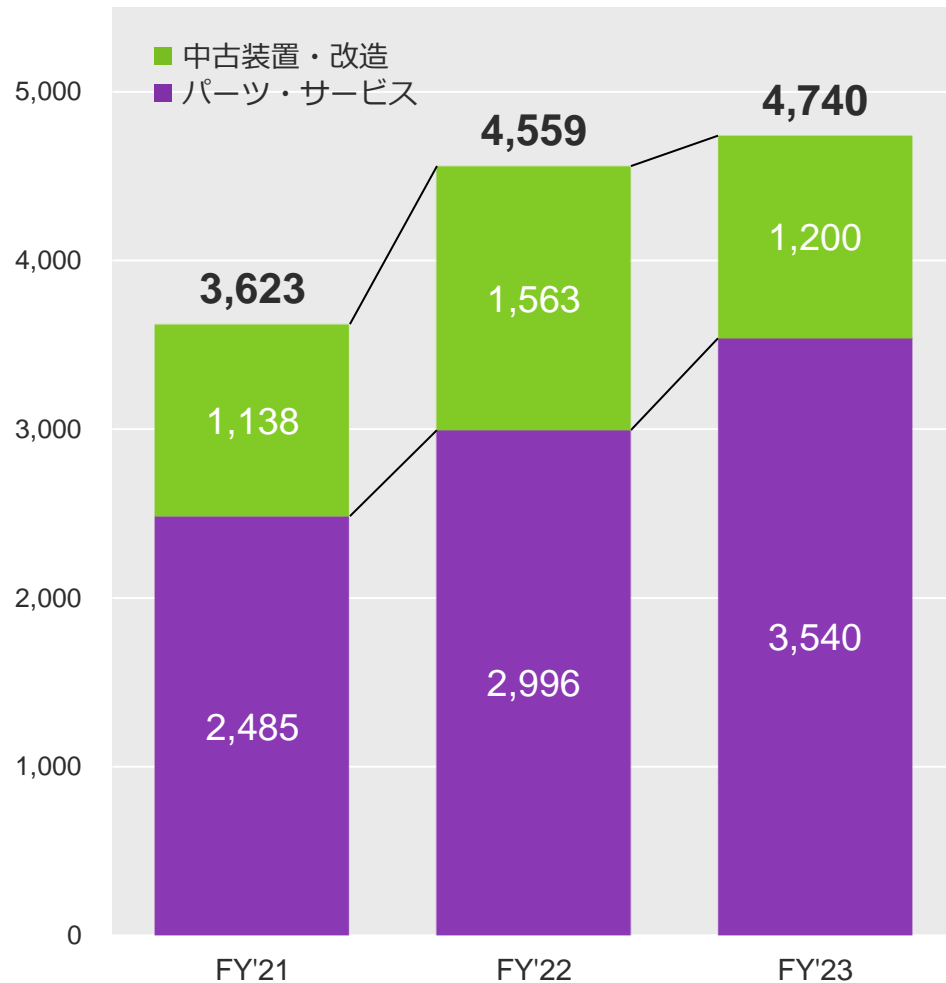
SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



- ロジック/ファウンドリでは、旺盛な投資を背景に、売上が大きく伸長
- 顧客の在庫調整に伴い、メモリ向け売上の構成比が減少

フィールドソリューション売上

(億円)

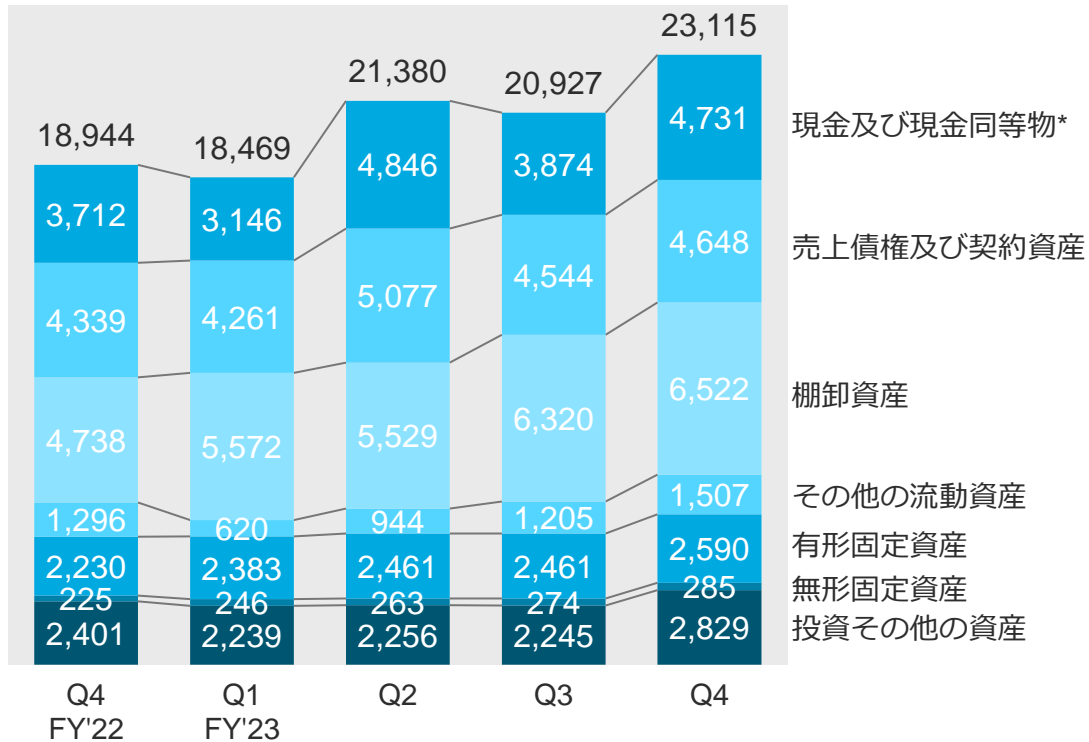


- FY2023 フィールドソリューションの売上は、前期比+4.0%の4,740億円
- パーツ・サービス売上は前期に引き続き堅調

貸借対照表 (四半期)

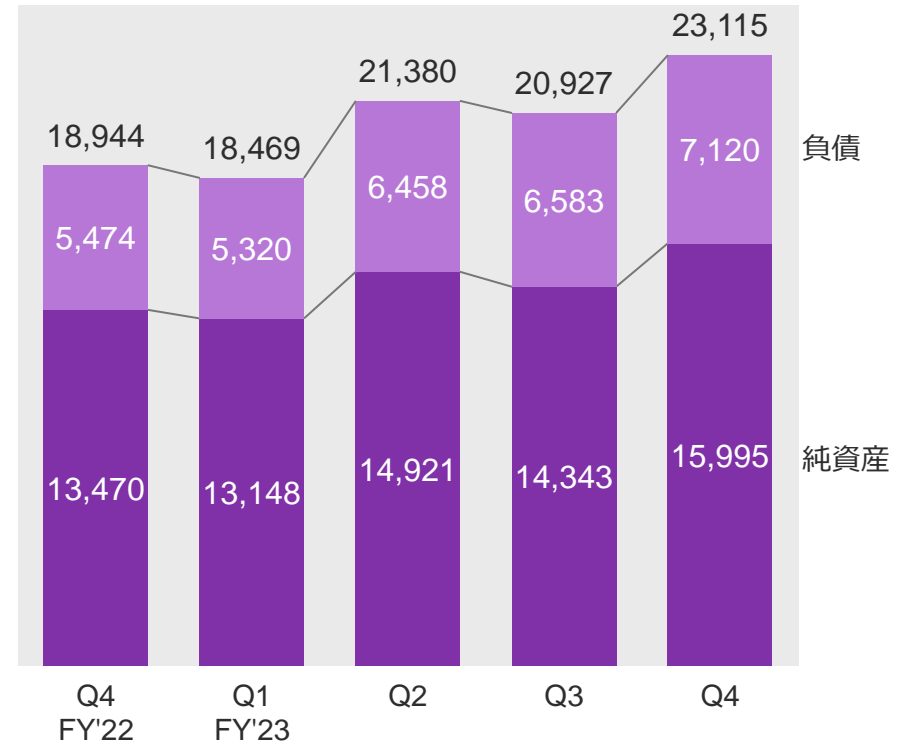
資産

(億円)



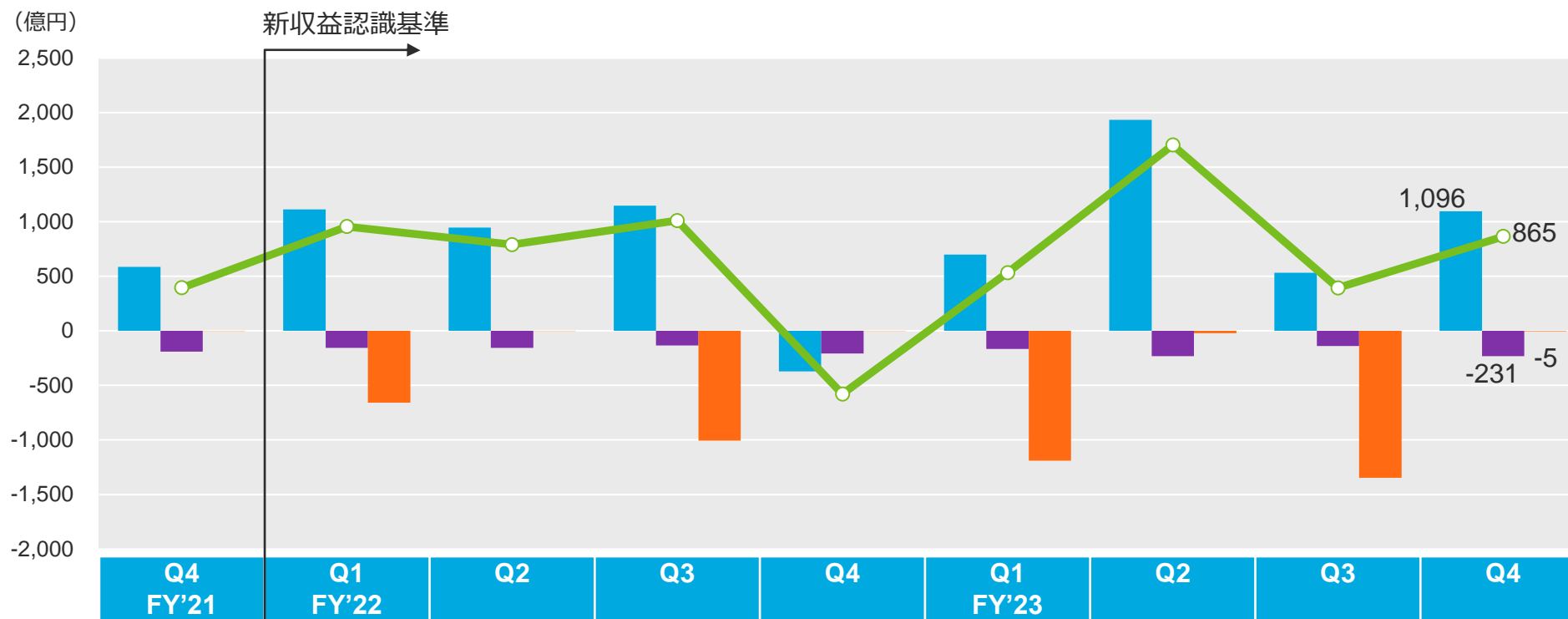
負債・純資産

(億円)



* 現金及び現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

キャッシュ・フロー



■ 営業キャッシュ・フロー	586	1,112	946	1,146	-371	699	1,934	532	1,096
■ 投資キャッシュ・フロー*1	-191	-157	-155	-135	-207	-166	-231	-138	-231
■ 財務キャッシュ・フロー	-1	-659	-2	-1,007	-2	-1,191	-21	-1,346	-5
○ フリーキャッシュ・フロー*2	394	955	790	1,010	-579	533	1,702	393	865
手元資金残高*3	3,115	3,417	4,204	4,239	3,712	3,146	4,846	3,874	4,731

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー (定期預金および短期投資の増減を除く)

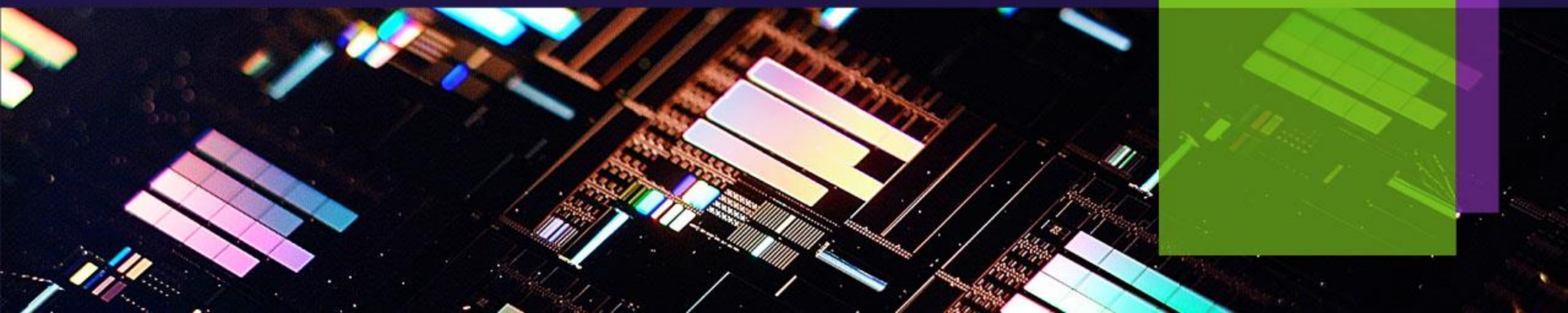
*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3か月を超える定期預金および短期投資の合計額です。



事業環境および業績予想

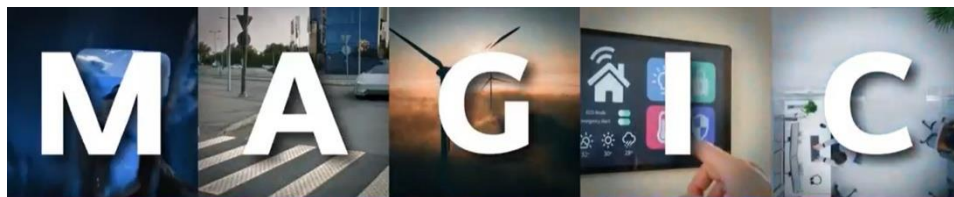
2023年5月11日

河合 利樹
代表取締役社長・CEO



FY2023 事業ハイライト

- 売上高、利益額ともに過去最高を更新
 - 売上高 2兆2,090億円、営業利益 6,177億円、当期純利益 4,715億円
- 過去最大となる1,911億円の研究開発投資を実施
- 戦略製品によるPOR*¹獲得や、将来成長に向けた開発装置選定も順調に進捗
- MAGIC市場対応強化に向けて、DSS*² BU発足。FY2024から始動



Metaverse Autonomous mobility Green energy IoT & information Communications

FY2023ハイライト：新ビジョンおよび中期経営計画の策定

半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社

東京エレクトロンは、世の中の持続的な発展を支える半導体の技術革新を追求します。

当社の専門性を生かし、付加価値の高い最先端の装置と技術サービスを継続的に創出することで、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。

そして、企業の成長は人、社員は価値創出の源泉と位置づけ、ステークホルダーとのエンゲージメントを通じて、このビジョンの実現に向けて活動してまいります。

財務目標（～FY'27）	
売上高	≥ 3兆円
営業利益率	≥ 35%
ROE	≥ 30%



Net Zero

スコープ 1 & 2 2040年までに実現
スコープ 3 2050年までに実現

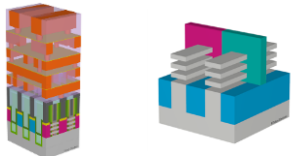
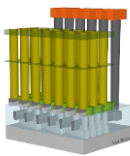
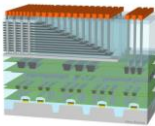
事業環境（2023年5月時点での見方）

- CY2023の半導体市場は前年比約10%の減少が予想されるが、CY2024はCY2022を上回る見込み
- WFE*1市場も目下調整局面だが、CY2023後半にロジック/ファウンドリから徐々に回復し、通年では\$70~75B程度になる見込み
- CY2024以降、半導体およびWFE市場は回復し、さらなる成長へ
 - マクロ経済の回復に伴う消費者向け電子機器需要と企業のIT投資回復
 - データ社会への移行に伴うデータセンター投資の拡大
 - 新CPUがサーバー入れ替えを促進（高性能化、低消費電力化）
 - 生成系AIの活用やメタバースなど新たなアプリケーションの拡大
 - マクロ経済回復に伴うスマホ需要の回復
 - OS移行に伴う、コロナ流行期に購入されたPCの買い替え需要
 - EV/自動運転の浸透による自動車の半導体搭載量増加が継続
 - 新たな技術世代への投資
 - DRAM：1b nm/1c nm、NAND：200層以上（一部CBA*2導入）、Logic：3 nm/2 nm世代（Nanosheet）

*1 WFE：半導体前工程製造装置（WFE：Wafer fab equipment）。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

*2 CBA：CMOS bonded array

事業機会と注力分野（～FY2025）

	Logic	DRAM	NAND
デバイスイメージ			
デバイスへの要求	低電力・高速CPU	高速ワーキングメモリ (DDR5)	大容量ストレージ
技術変化	<ul style="list-style-type: none"> GAA Nanosheet Backside PDN*1 	<ul style="list-style-type: none"> EUV HKMG*2 CMOS周辺回路 	<ul style="list-style-type: none"> 高積層化 Multi-tier stack 周辺回路貼り合わせ メモリセル向け新材料導入
事業機会	<ul style="list-style-type: none"> 高選択比エッチング 新材料成膜 超臨界乾燥 ボンディング・レーザートリミング 	<ul style="list-style-type: none"> EUV向けコータ/デベロッパ 新材料成膜 超臨界乾燥 	<ul style="list-style-type: none"> HARCエッチング ウェットエッチング/新乾燥技術 新低抵抗メタル ボンディング ウェーハ反り抑制技術

成長機会はますます拡大

FY2024 業績予想

FY2024 業績予想

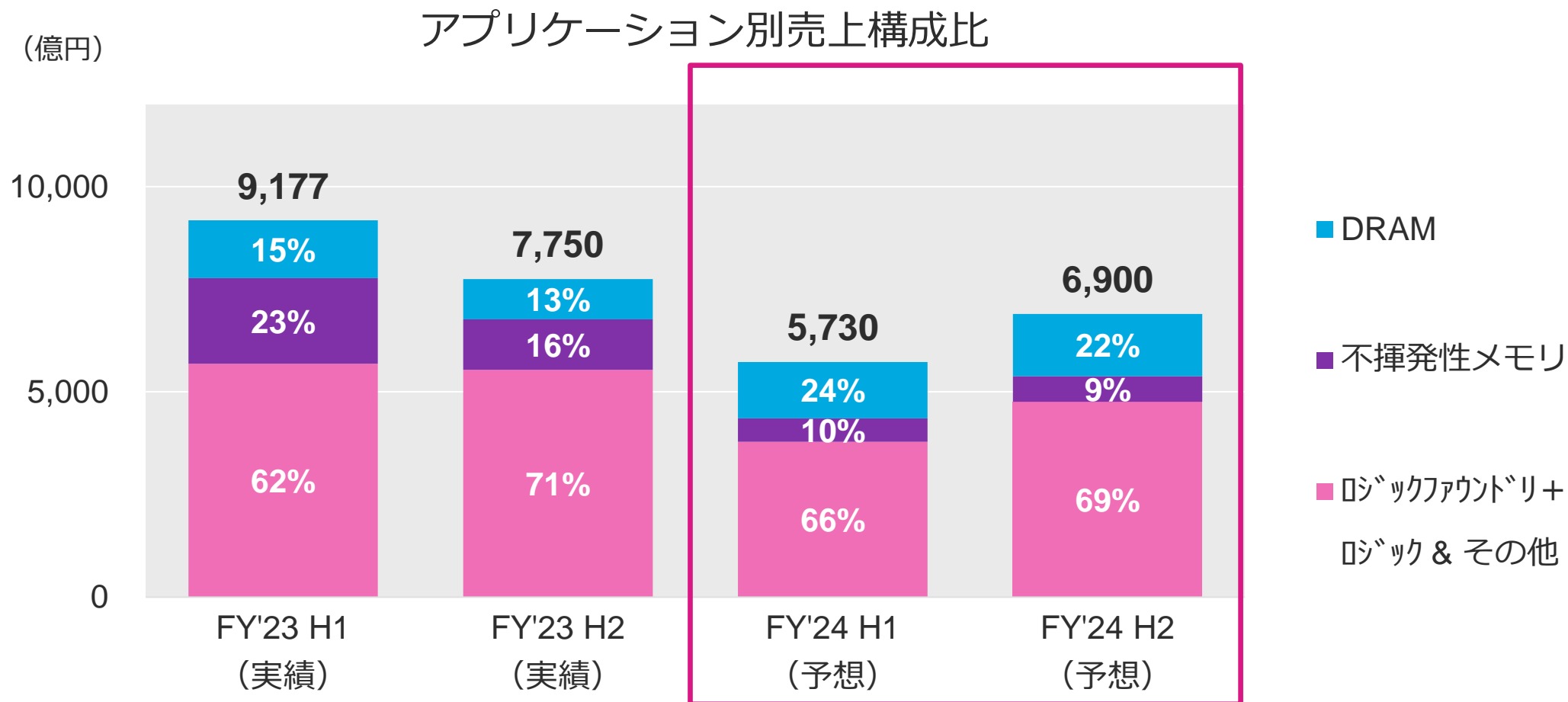
(億円)

	FY2023 (実績)	FY2024 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前期増減
売上高	22,090	7,900	9,100	17,000	-23.0%
売上総利益	9,844	3,330	4,080	7,410	-24.7%
下段：売上総利益率	44.6%	42.2%	44.8%	43.6%	-1.0pts
販管費	3,666	1,720	1,760	3,480	-5.1%
研究開発費	1,911	950	1,050	2,000	+4.7%
研究開発費以外の販管費	1,754	770	710	1,480	-15.7%
営業利益	6,177	1,610	2,320	3,930	-36.4%
下段：営業利益率	28.0%	20.4%	25.5%	23.1%	-4.9pts
税金等調整前当期純利益	6,248	1,620	2,330	3,950	-36.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	4,715	1,200	1,800	3,000	-36.4%
1株当たり当期純利益 (円)	1,007.82	256.21	-	640.53	-367.29

当社は、2023年4月1日付で普通株式1株を3株に株式分割しております。
前連結会計年度の期首に当該株式分割がおこなわれたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。

販管費は前期比5%低減も、研究開発費は過去最大の2,000億を見込む

FY2024 SPE新規装置売上予想



今上期が売上の底となり、その後回復基調へ

グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれておりません。

FY2024 研究開発費・設備投資計画

新開発棟
(成膜装置、エッチング装置、コーポレート開発)



山梨県富士崎市
(2023年夏 竣工予定)

東北生産・物流センター
(成膜装置)



岩手県奥州市
(2025年秋 竣工予定)

新開発棟
(コータ/デベロッパ、サーフェスプレパレーション)



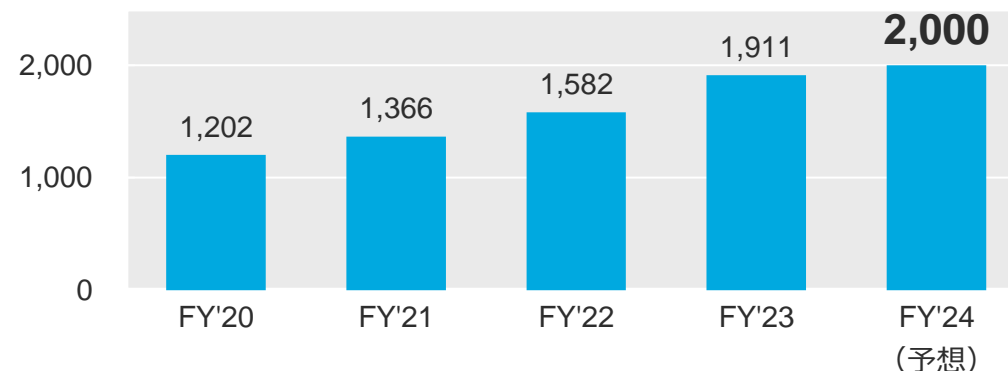
熊本県合志市
(2025年夏 竣工予定)

新開発棟
(エッチング装置)

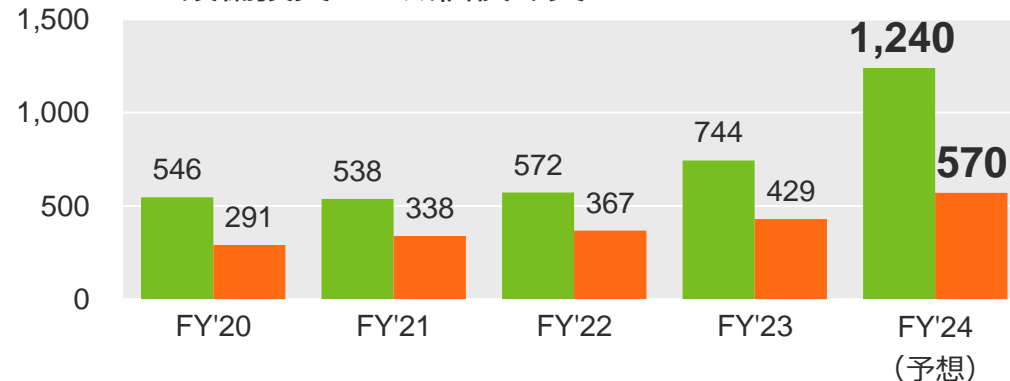


宮城県黒川郡
(2025年春 竣工予定)

(億円) ■ 研究開発費

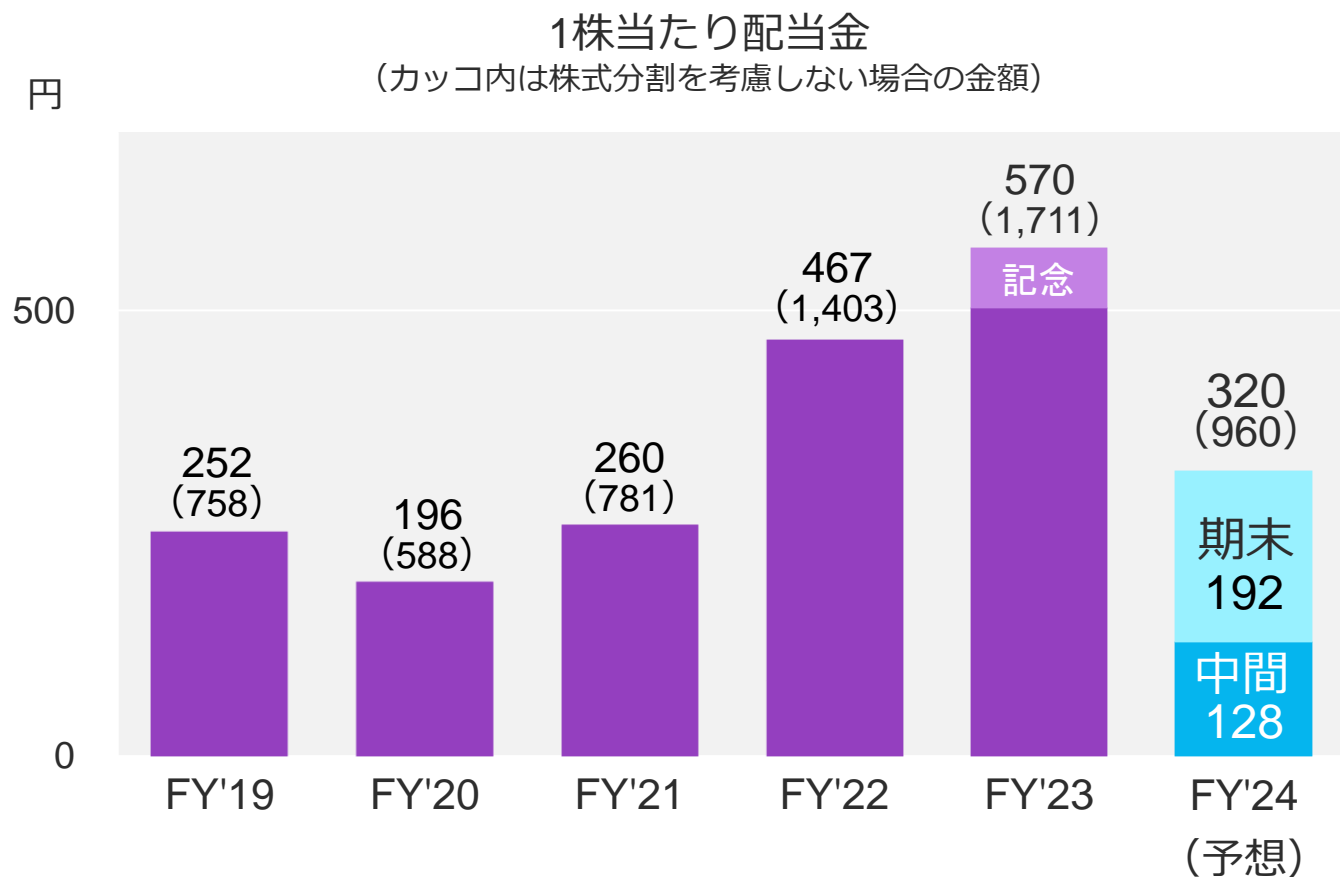


(億円) ■ 設備投資 ■ 減価償却費



持続的成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

FY2024 配当予想



FY'19~23の1株当たり配当額は、FY'19の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しております。
FY'23には60周年記念配当が含まれます。
株式分割がおこなわれる以前の金額を括弧で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しております。

本年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は320円を予定

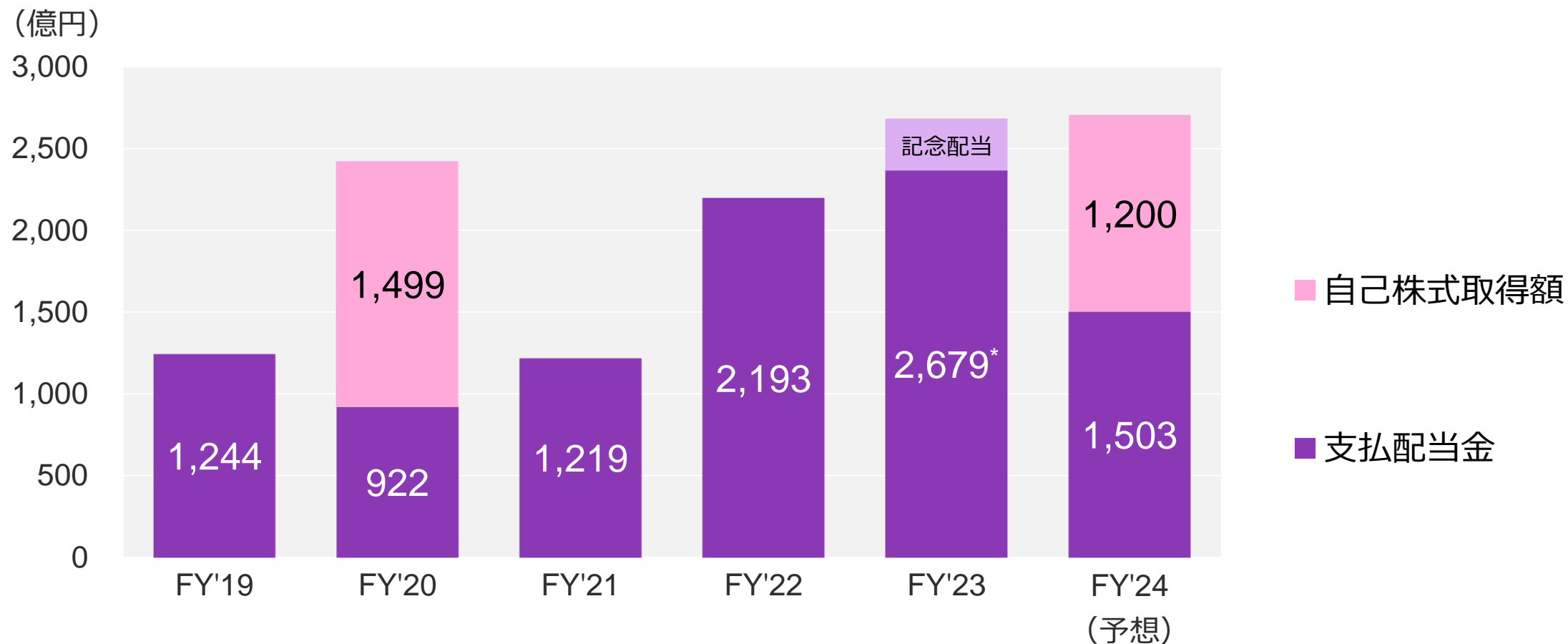
自己株式の取得について

最大1,200億円の自己株式取得を予定

- 取得対象株式の種類 当社普通株式
- 取得し得る株式の総数 1,000万株（上限）
（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 2.1%）
- 株式の取得価額の総額 1,200億円（上限）
- 取得する期間 2023年6月1日～2023年12月31日

キャッシュ創出力と必要手元資金、成長投資資金を考慮し、
今後も機動的にバランスシート・マネジメントをおこないます

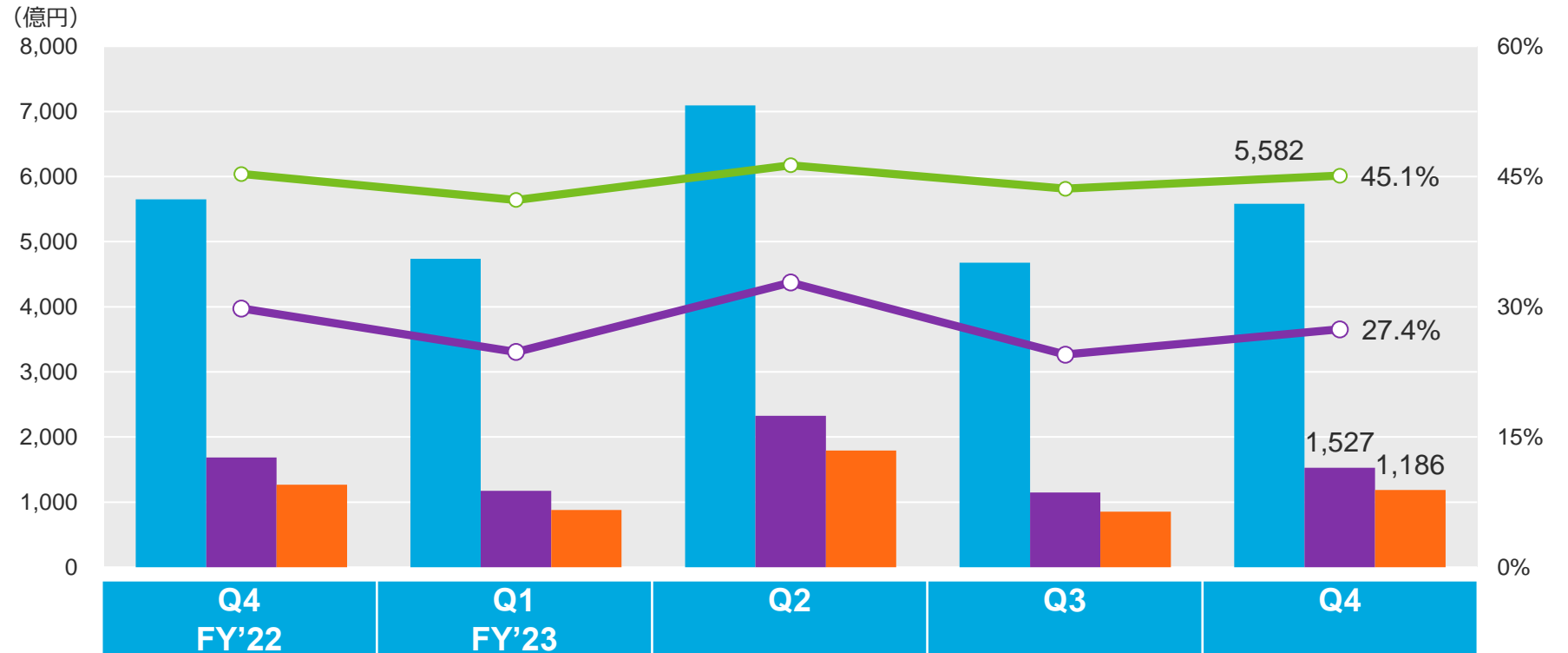
総還元額



*FY'23の支払配当金2,679億円には記念配当分（313億円）が含まれます。

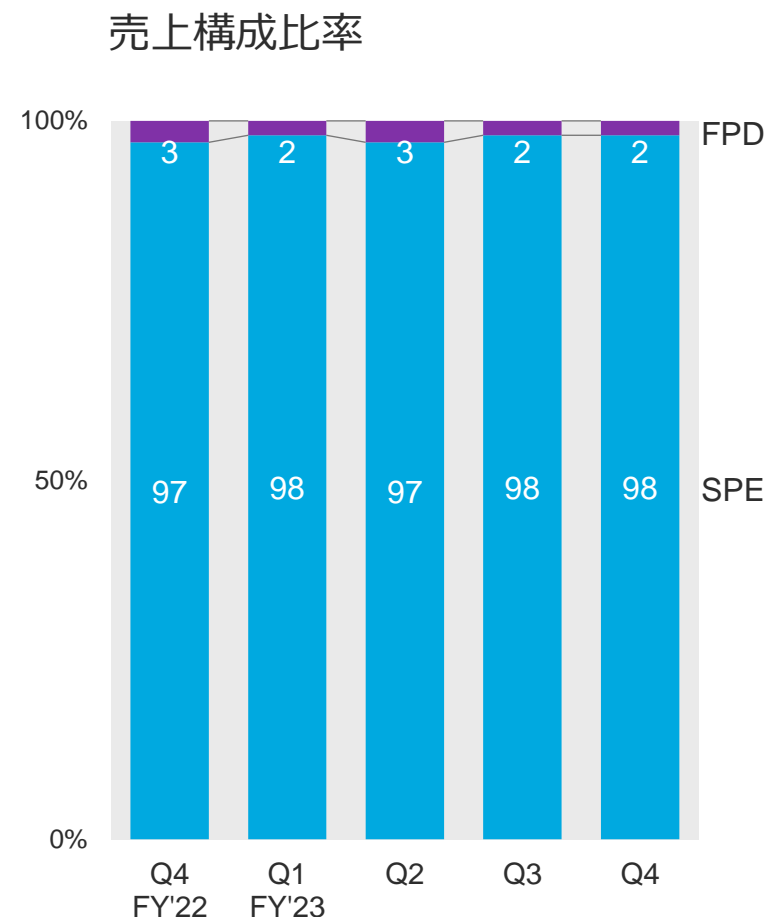
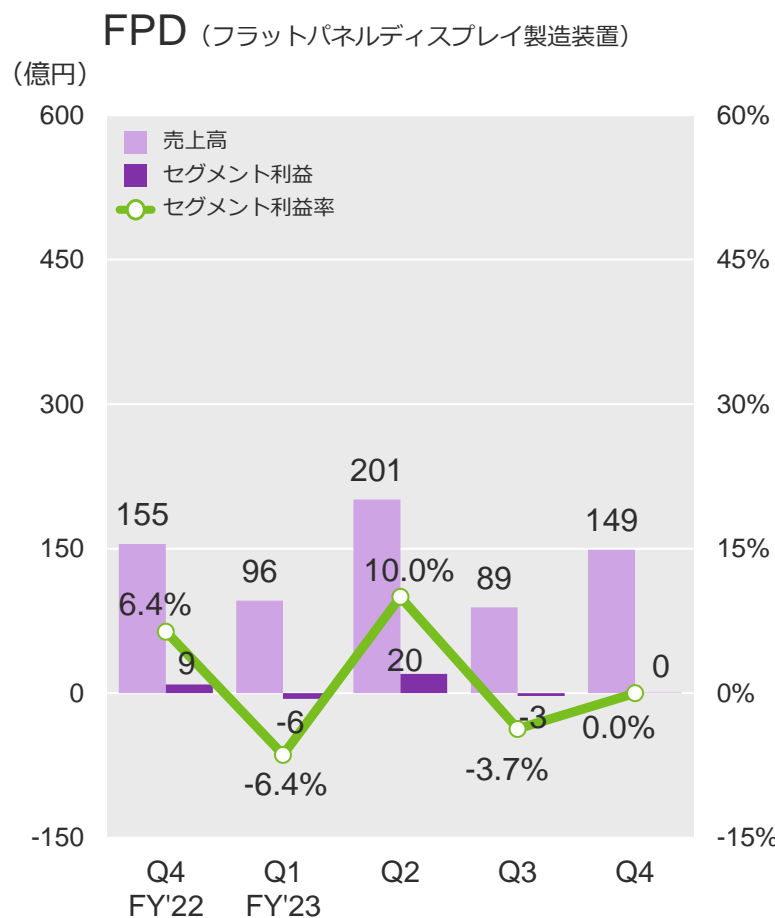
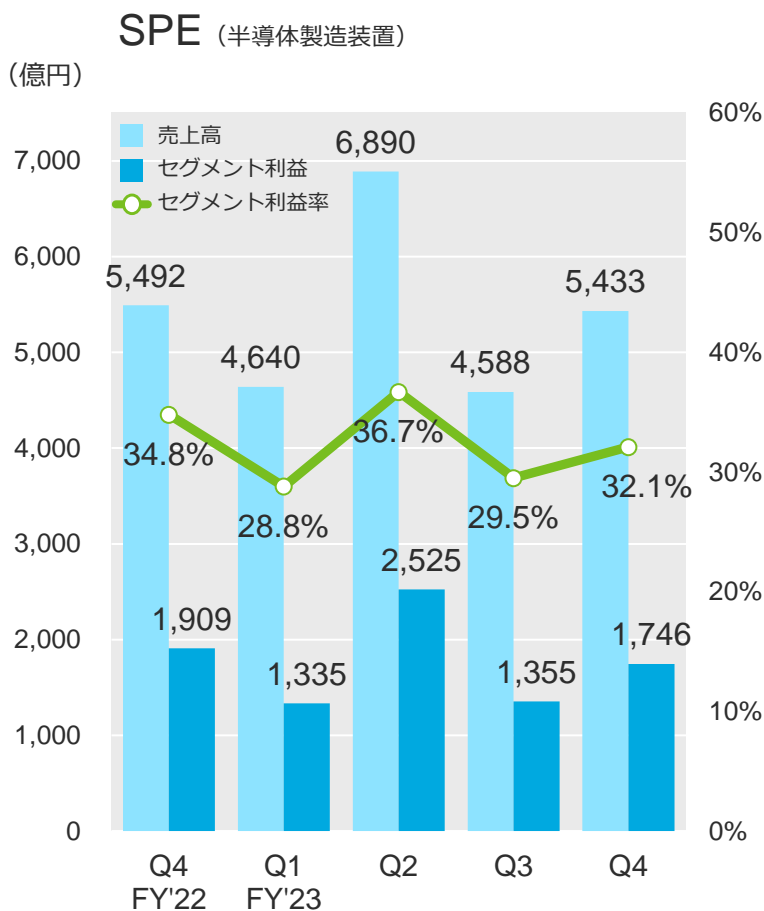
補足資料

損益状況 (四半期)



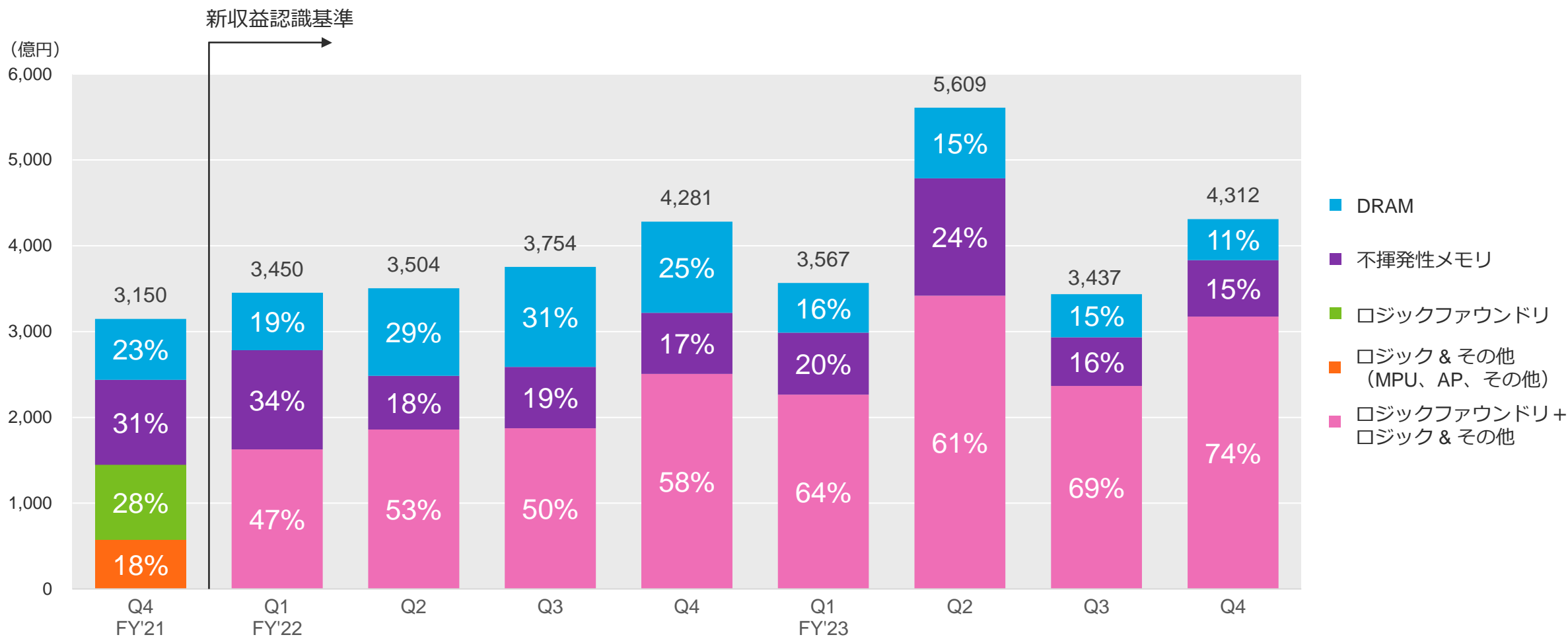
■ 売上高	5,648	4,736	7,092	4,678	5,582
■ 営業利益	1,685	1,175	2,326	1,147	1,527
■ 親会社株主に帰属する 当期純利益	1,268	880	1,792	855	1,186
○ 売上総利益率	45.3%	42.3%	46.3%	43.6%	45.1%
○ 営業利益率	29.8%	24.8%	32.8%	24.5%	27.4%

セグメント情報（四半期）

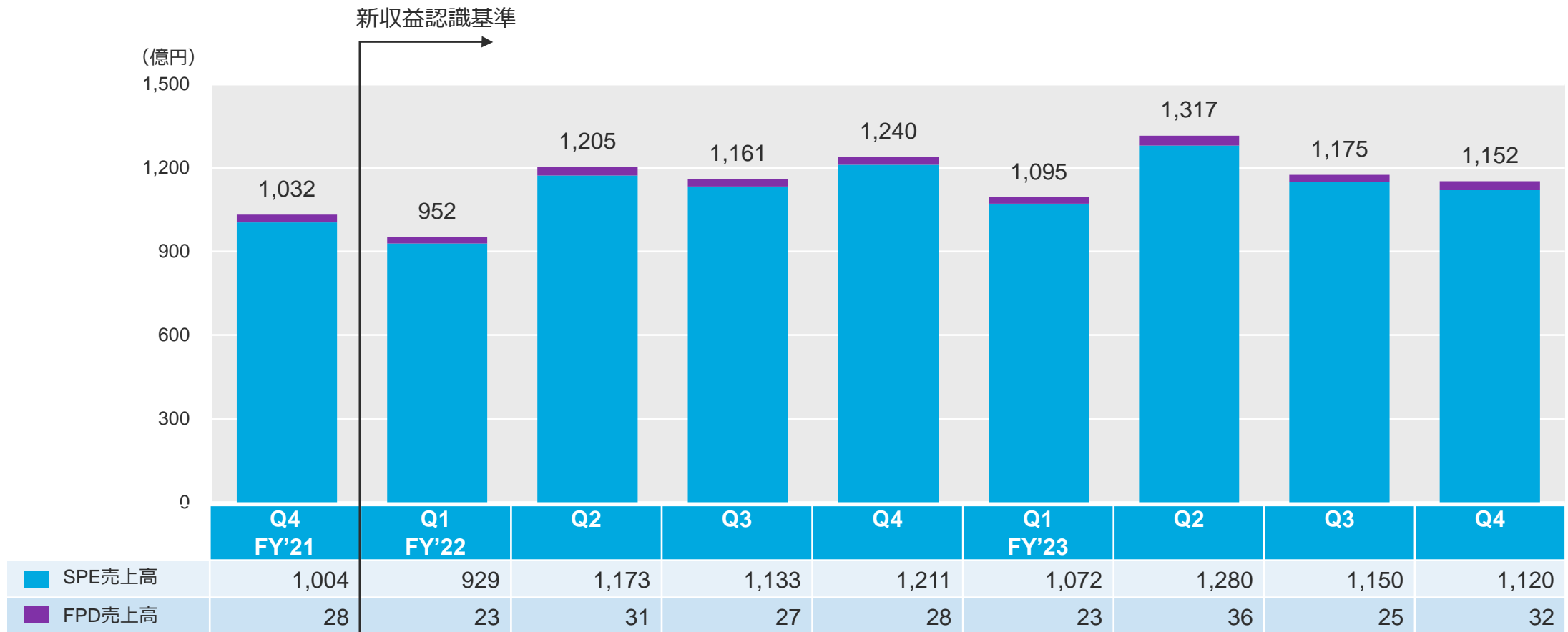


1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究又は要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

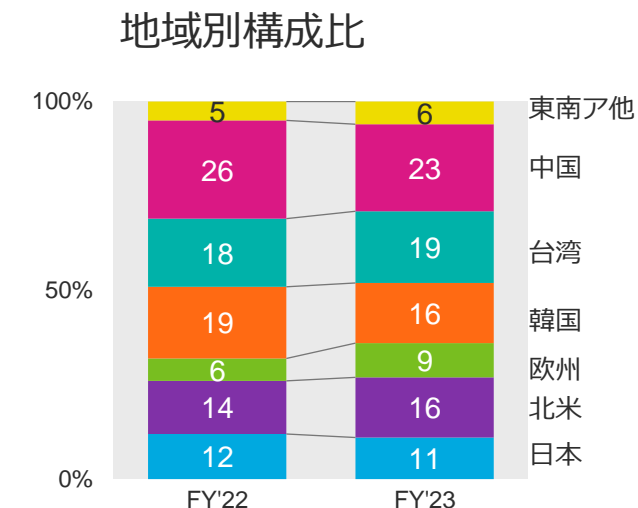
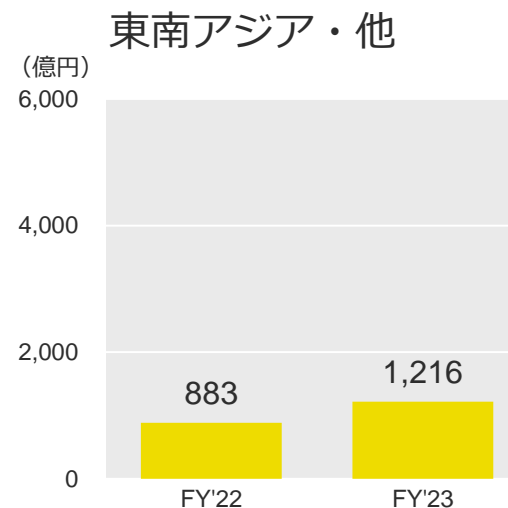
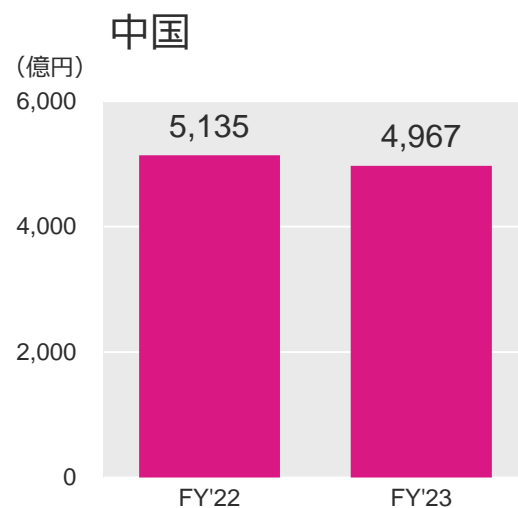
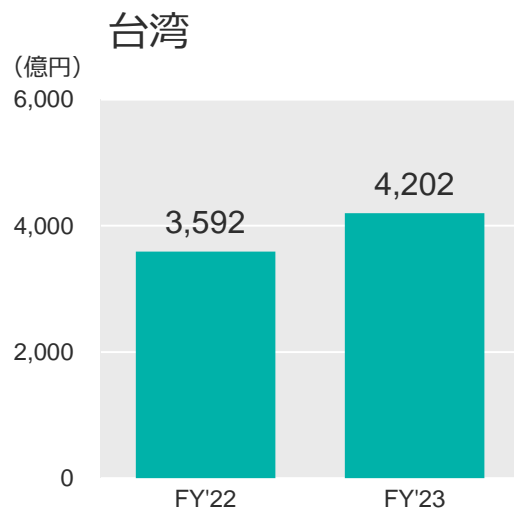
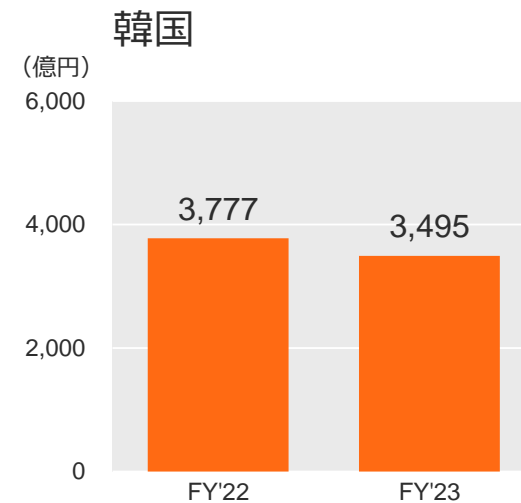
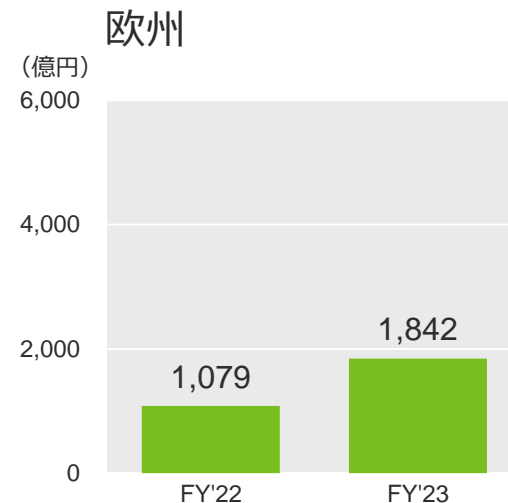
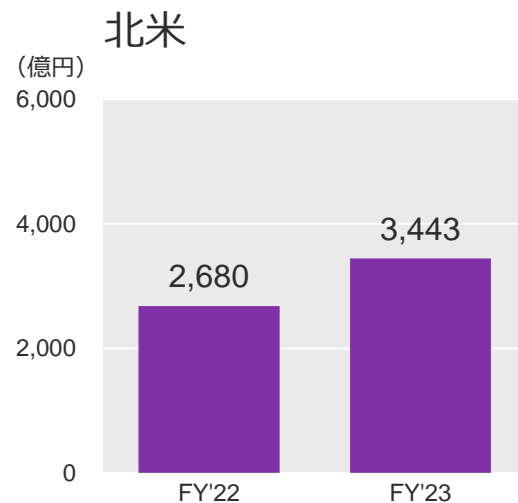
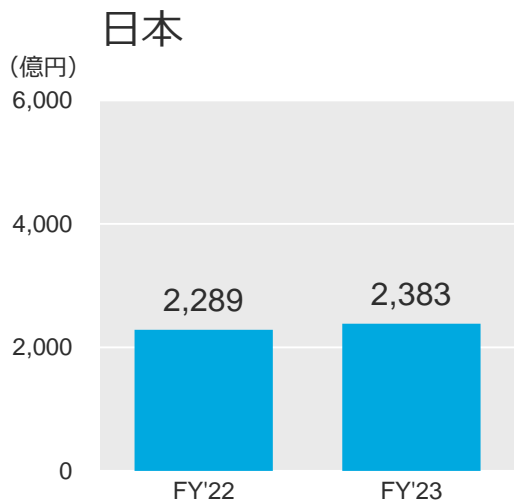
SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）



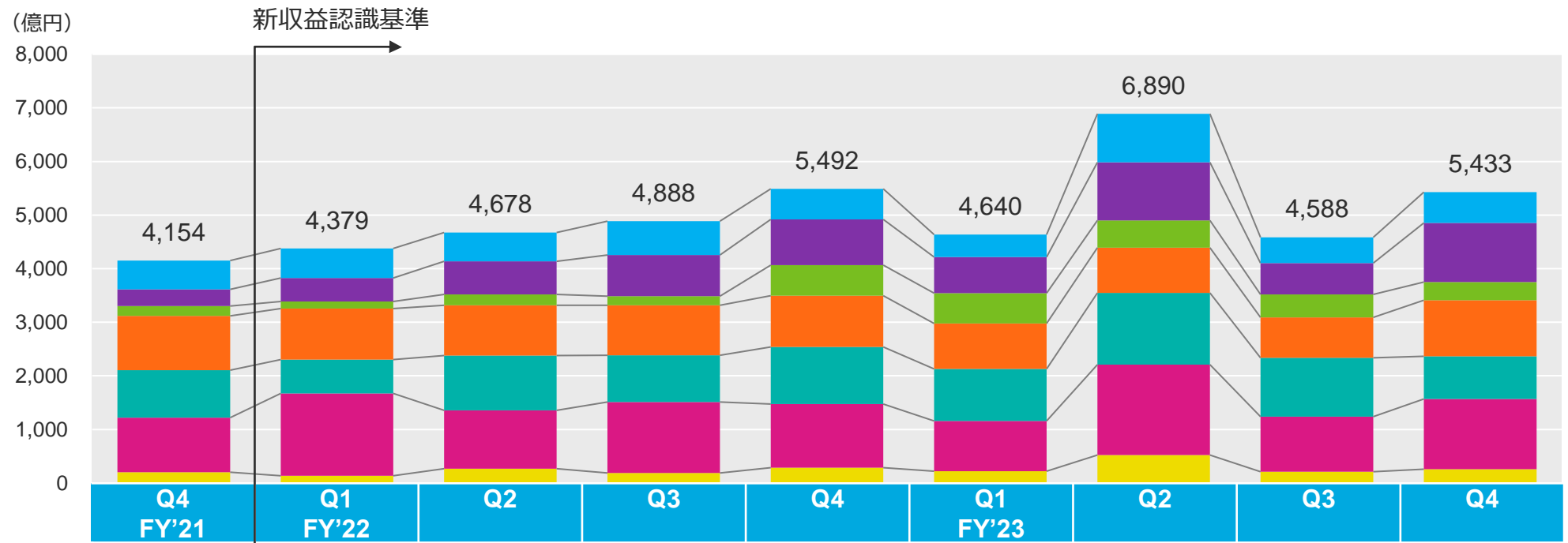
フィールドソリューション売上高（四半期）



SPE部門 地域別売上高

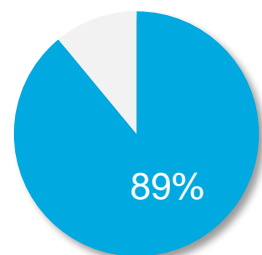


SPE部門 地域別売上高 (四半期)

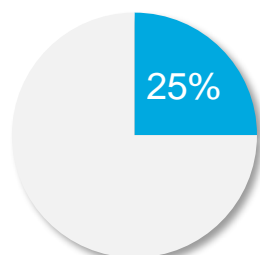


地域	Q4 FY'21	Q1 FY'22	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'23	Q2	Q3	Q4
日本	536	548	539	631	569	420	905	482	576
北米	312	439	618	768	853	673	1,083	584	1,102
欧州	186	134	203	170	571	565	509	426	341
韓国	1,014	953	935	930	959	851	842	754	1,047
台湾	882	628	1,025	874	1,063	968	1,338	1,101	794
中国	1,022	1,536	1,088	1,322	1,188	940	1,686	1,027	1,312
東南アジア・他	200	138	267	189	287	220	525	211	258

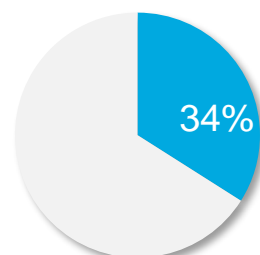
TEL SPE* 主要プロダクト 世界市場シェア (CY2022)



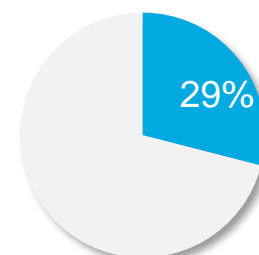
コータ/デベロッパ



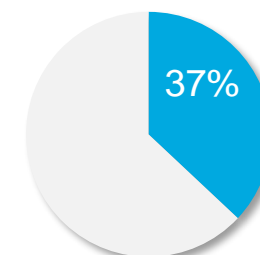
ドライエッチング装置



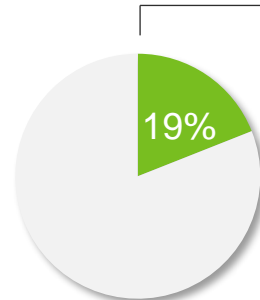
成膜装置



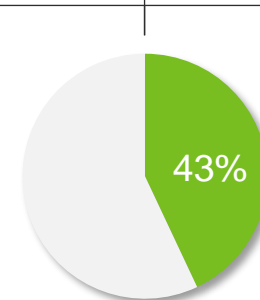
洗浄装置



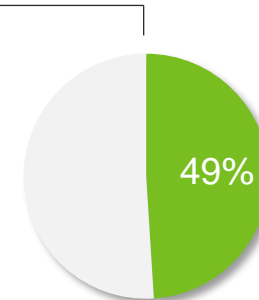
ウェーハプローバ



ALD



CVD



酸化/拡散

出所

半導体製造装置（ウェーハプローバを除く）: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2022, Bob Johnson, Gaurav Gupta, Menglin Cao, 17 April 2023

図はガートナーリサーチに基づき、東京エレクトロンが作成。ここに記載のある数値は、東京エレクトロンにより算出されたものです。

コータ/デベロッパ: Photoresist Processing (Track), ドライエッチング装置: Dry Etch, 成膜装置: Tube CVD + Atomic Layer Deposition Tools + Oxidation/ Diffusion Furnaces + Nontube LPCVD, ALD: Atomic Layer Deposition Tools, CVD: Tube CVD + Nontube LPCVD, 酸化/拡散: Oxidation/Diffusion Furnaces, 洗浄装置: Single Wafer Processors + Wet Stations + Batch Spray Processors + Scrubbers + Other Clean Equipment GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

出所

半導体製造装置（ウェーハプローバ）:

TechInsights Manufacturing Analysis Inc., April 2023
図はTechInsights Manufacturing Analysis Inc.に基づき、東京エレクトロンが作成。

TEL™

TOKYO ELECTRON